

株式会社東京精密 2024年度(2025年3月期) 第3四半期 決算説明会

2025年2月4日

代表取締役社長 COO 木村 龍一
代表取締役副社長 CFO 川村 浩一
経営支援室 IRチームリーダー 高嶋 直樹

◆ **将来の事象に係わる記述に関する注意**

- 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ **表記データ・用語について**

- 注記がある場合を除き、**半導体製造装置セグメント**を「半導体」、**精密計測機器セグメント**を「計測」、また**親会社株主に帰属する当期純利益**を「当期純利益」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。
- 2022年度より、在外子会社の収益及び費用は、従来の期末レートから期中平均レートにより円換算する方法に変更しております。これに伴い、補足資料の2021年度の数値は、期中平均レートを遡及適用した数値を記載しております。

◆ **監査について**

- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

2024年度 第3四半期(累計)業績



全社業績(億円、円)	2023年度		2024年度		
	第3四半期(累計)		第3四半期(累計)		前年同期比
受注高	896		1,104		+23%
売上高	889		1,031		+16%
営業利益 (営業利益率)	144 (16%)		191 (19%)		+33%
経常利益	151		198		+31%
当期純利益	106		181		+71%

セグメント別業績 (億円)		2023年度		2024年度		
		第3四半期(累計)		第3四半期(累計)		前年同期比
半導体 製造装置	受注高	625		812		+30%
	売上高	645		774		+20%
	営業利益 (営業利益率)	109 (17%)		156 (20%)		+43%
計測機器	受注高	272		292		+8%
	売上高	243		258		+6%
	営業利益 (営業利益率)	35 (14%)		35 (14%)		-0%

- 半導体を中心に前年同期比 増収増益
- 受注高は両セグメントとも前年同期比 増加

February 4th, 2025

Copyright 2025 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

3

- 代表取締役社長COO の木村です。日頃大変お世話になっております。
- それでは、2024年度第3四半期の業績を説明させていただきます。
まず、3ページ、第3四半期累計期間の業績ですが、
概ね計画通りに出荷・据付を進め、前年同期比 で増収増益の着地となりました。
- 受注高も、両セグメントともに増加しました。
- セグメント別業績は、下段に記載の通りです。

四半期業績推移



全社業績(億円)	2023年度				2024年度				
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	前四半期比	前年同期比
受注高	295	299	301	312	374	337	392	+16%	+30%
売上高	266	369	254	458	296	418	317	-24%	+25%
営業利益 (営業利益率)	43 (16%)	71 (19%)	30 (12%)	109 (24%)	41 (14%)	93 (22%)	57 (18%)	-39%	+89%
経常利益	47	74	30	114	43	88	66	-25%	+122%
当期純利益	32	53	21	88	36	100	46	-54%	+121%

前年同期比で増収増益

セグメント別業績 (億円)		2023年度				2024年度				
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	前四半期比	前年同期比
半導体 製造装置	受注高	203	220	202	236	271	246	295	+20%	+46%
	売上高	187	282	176	355	220	323	230	-29%	+31%
	営業利益 (営業利益率)	32 (17%)	58 (20%)	19 (11%)	90 (25%)	33 (15%)	78 (24%)	44 (19%)	-43%	+133%
計測機器	受注高	92	80	100	76	103	91	98	+8%	-2%
	売上高	79	87	78	103	76	95	87	-9%	+11%
	営業利益 (営業利益率)	10 (13%)	14 (16%)	11 (14%)	19 (19%)	8 (10%)	15 (16%)	12 (14%)	-19%	+12%

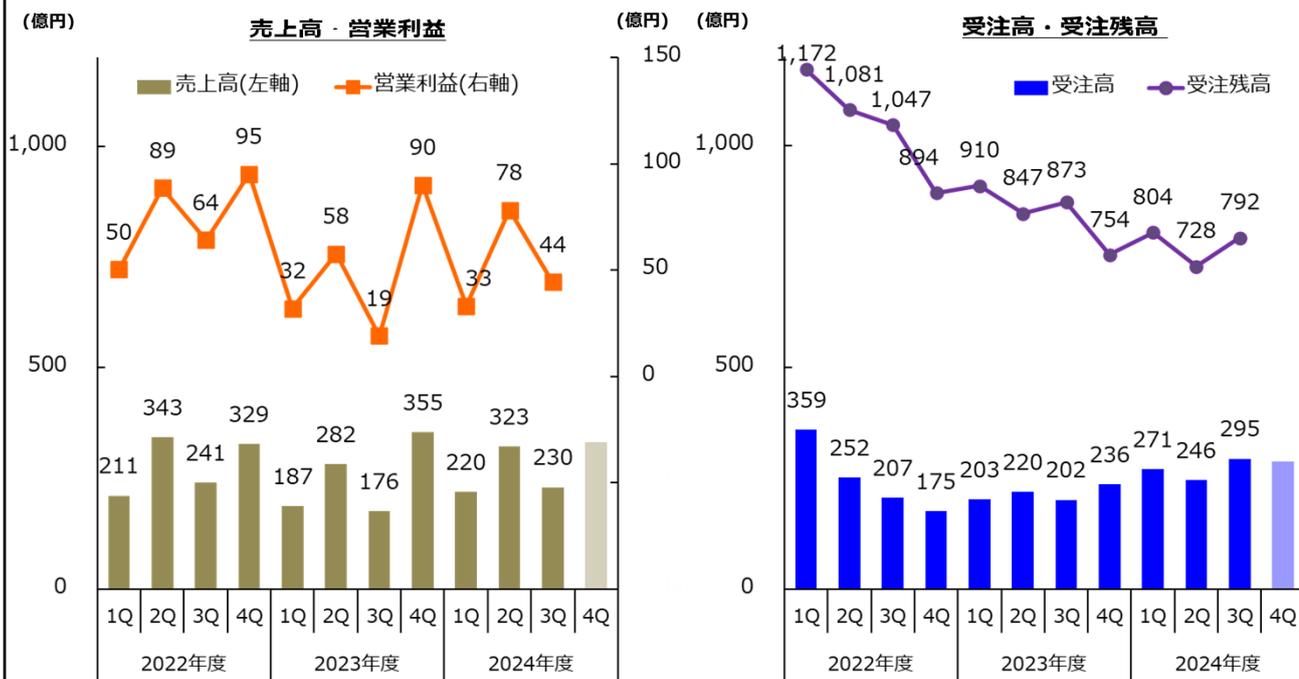
両セグメントとも前年同期比で増収増益

February 4th, 2025

Copyright 2025 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

4

- 4ページは、第3四半期 3か月間の業績説明です。
- 上段ですが、第3四半期は、前年同期比で増収増益となりました。
なお、第2四半期の売上高が高水準だったため、前四半期比では減収となっております。
- セグメント別の業績は、下段に記載の通りです。



- 売上高・営業利益：概ね想定線の推移、第4四半期は増収を想定
- 受注・受注残高：生成AI・HPC需要が底堅く、弱い民生・パワー関連需要を補い、想定を上振れ

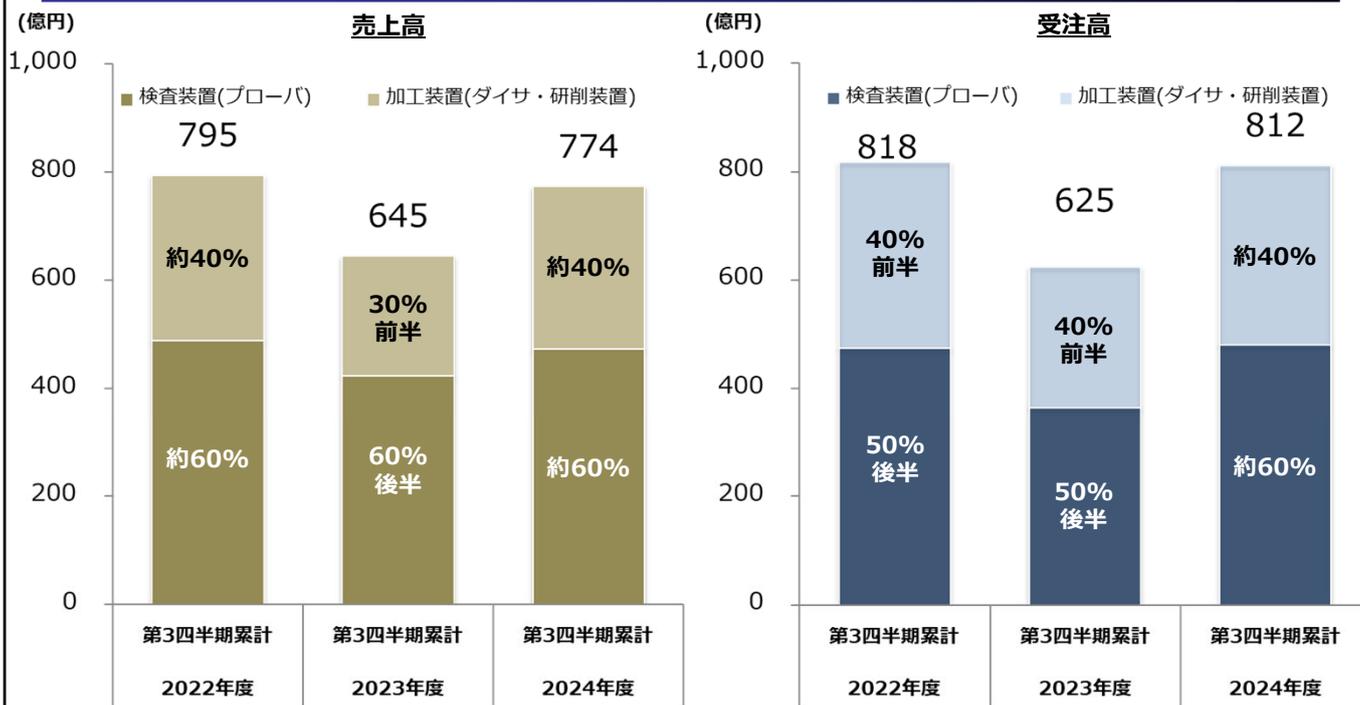
February 4th, 2025

Copyright 2025 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

5

- 5ページは、半導体の四半期推移をグラフ化したものです。
- 左側、売上高のグラフですが、出荷が概ね計画通りに進んでおり、第4四半期も増収の計画としています。
- 右側、受注高のグラフですが、この第3四半期の受注は想定を上回りました。生成AI、HPC関連で、プローバ、グラインダに強い引き合いがあり、弱い民生需要やパワー半導体需要を十分に補いました。
- 第4四半期についても、この強い引合いが継続すると考えています。それにより、下期の受注高は11月の想定を上回ると見込んでおります。

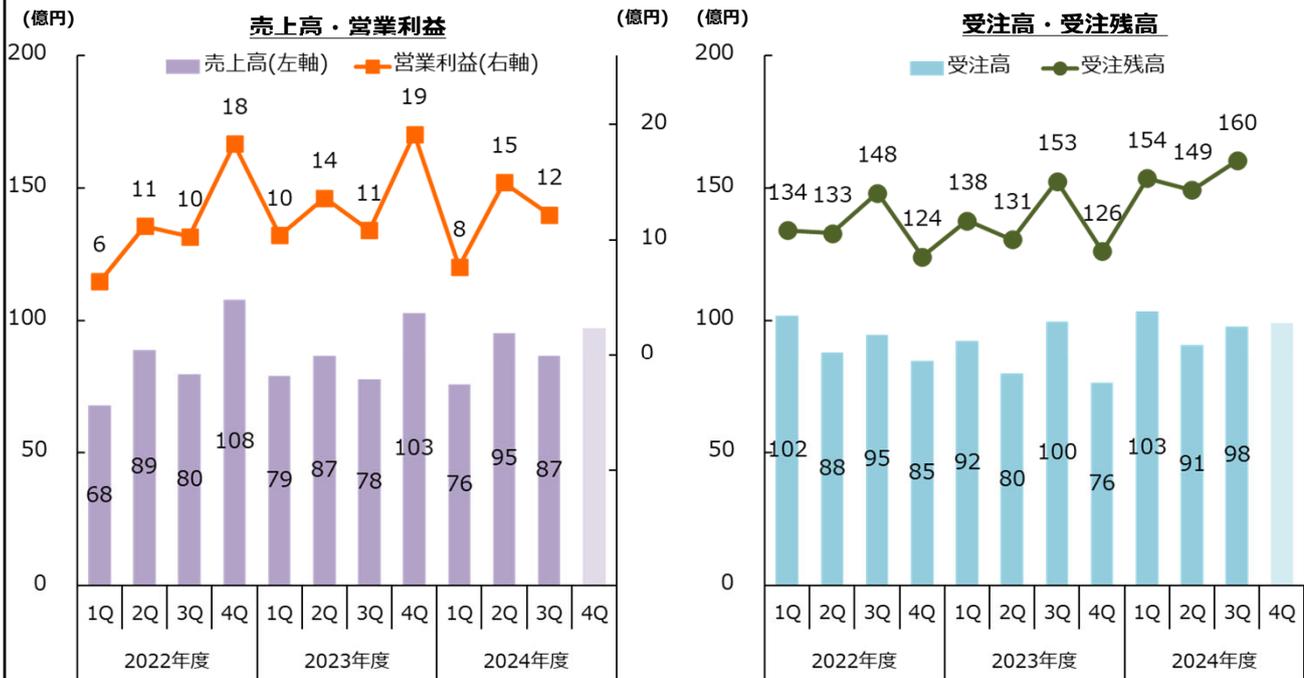
半導体 - 製品別動向



➤ 製品別構成比に、大きな変化は無い

○ 6ページは、第3四半期累計の半導体の製品別売上高、受注高の推移です。

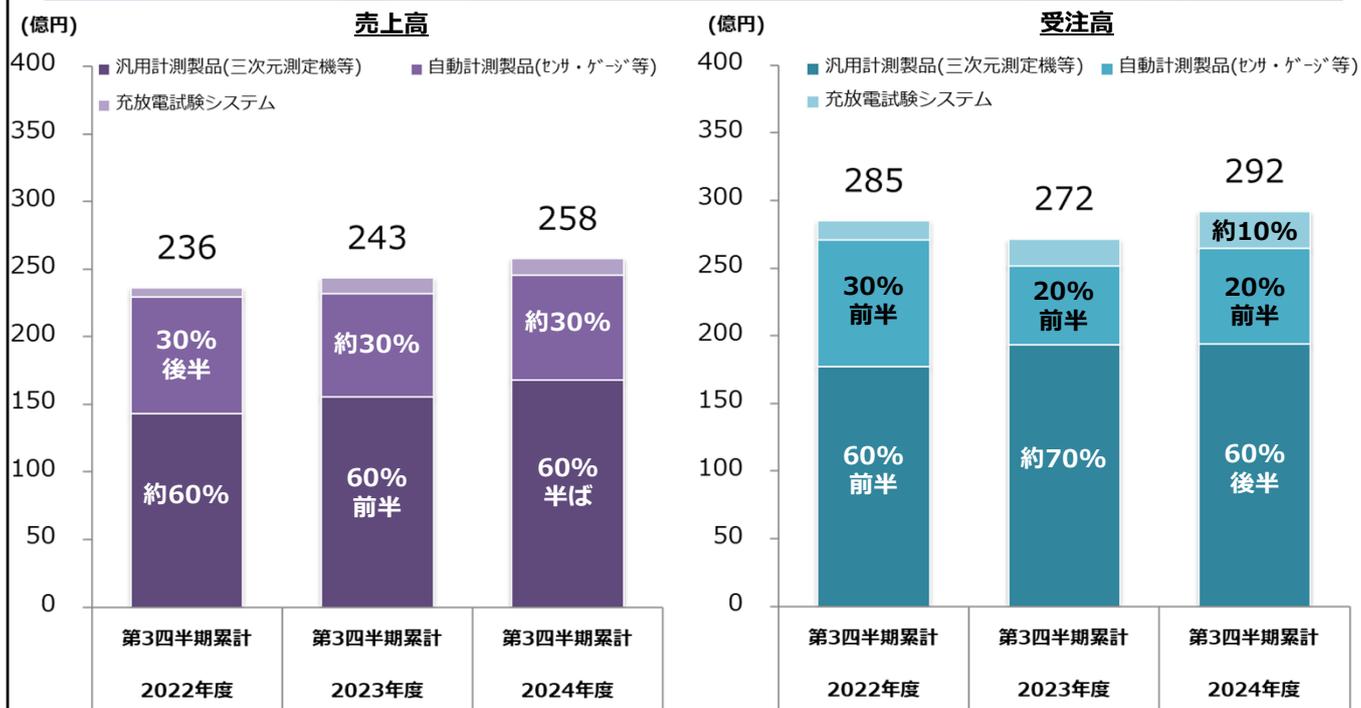
○ 構成比に大きな変化はございません。



- 売上高・営業利益：概ね想定線の推移、第4四半期は増収を想定
- 受注・受注残高：ICE向け新規投資が停滞も、更新需要・充放電の受注が下支え

- 7ページは、計測の四半期推移をグラフ化したものです。
- 左側、売上高のグラフですが、出荷は、半導体同様、概ね想定線です。第4四半期は増収を計画しています。
- 右側、受注高のグラフですが、内燃機関向けの新規投資は停滞していますが、更新需要に加えて、国内自動車メーカー向けに充放電試験システムの受注を獲得したことなどから、想定並みの着地となりました。なお、第4四半期の受注は、第3四半期並みを想定しています。

計測 - 製品別動向



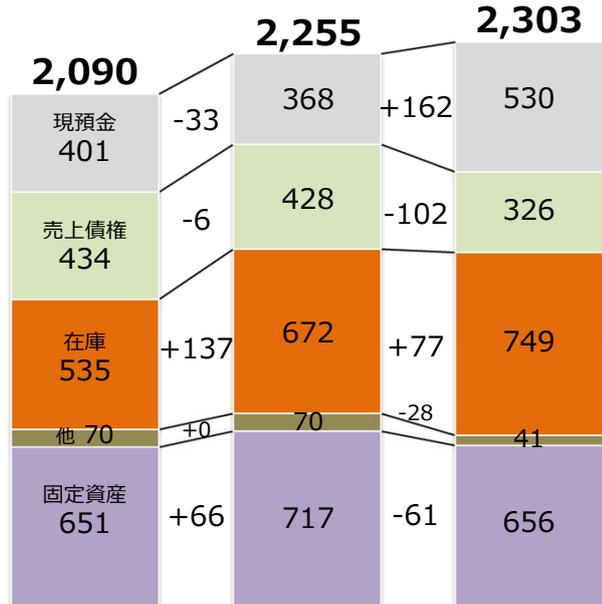
➤ 充放電試験システムの受注構成比が増加

- 8ページは、第3四半期累計の計測の製品別売上高、受注高の推移です。
- 右側、受注高のグラフですが、充放電試験システム事業の構成比は約10%となりました。こちらは、主に車載向け各種電池の開発需要を獲得していることによります。

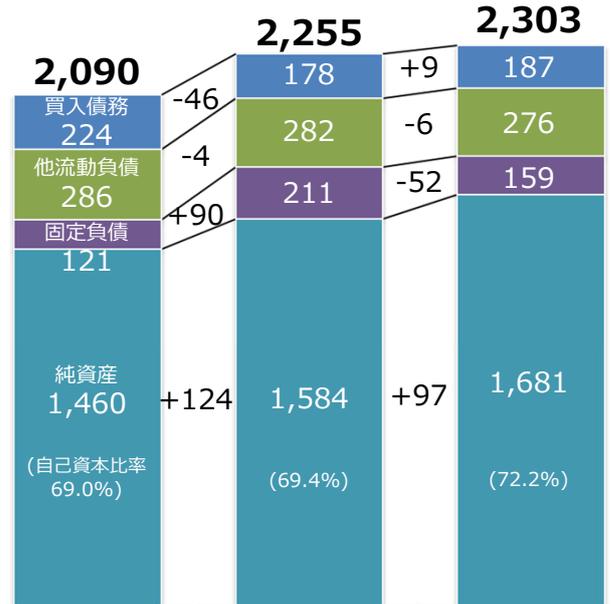
貸借対照表



資産の部(億円)



負債・純資産の部(億円)



2023年3月末

2024年3月末

2024年12月末

2023年3月末

2024年3月末

2024年12月末

➤ 資産の部：売上債権の回収・固定資産の譲渡(第2四半期)等により現預金が増加

➤ 負債・純資産の部：長期借入金が減少

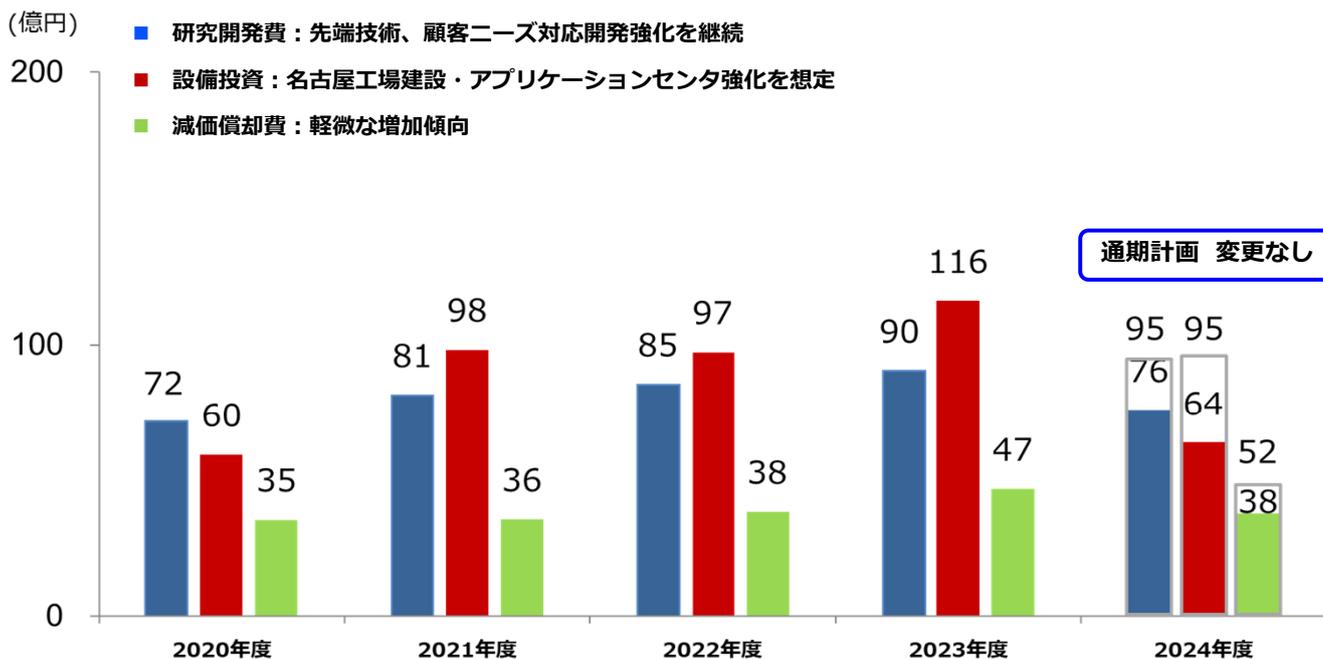
February 4th, 2025

Copyright 2025 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

9

- 9ページは貸借対照表の説明です。
- 12月末の総資産は、2,303 億円となりました。
- 左側、資産の部ですが、
現預金は、第2四半期の固定資産譲渡や、売掛金の回収等により増加しています。
- 右側、負債・純資産の部については、
借入金の返済により、負債が減少しています。
- 12月末の自己資本比率は 72.2%となりました。

試験研究費、設備投資、減価償却



➤ 2024年度 研究開発費等の計画に変更なし

- 10ページは、試験研究費、設備投資、減価償却の説明です。第3四半期までの実績と今期の計画です。
- 第3四半期までの実績は、ご覧の通りです。今期計画の変更はございません。
- ここまでが、第3四半期の実績説明となります。

売上・営業利益

半導体：計画通りの出荷・据付による売上高の計上が前提

- 生成AI関連：下期は、上期と同水準の売上を計画 (2024年度通期売上高は前年比倍増)
- 中国需要：受注済案件の出荷・据付が計画通り続く
- パワー関連：Si/SiC向けともに、受注済案件の出荷・据付が計画通り続く
- グローバルOSAT：下期の受注回復による期中売上は織り込まず

計測：汎用・自動計測は緩やかに回復、充放電は受注から納入までの期間が長く売上増加は来期以降

利益：部材価格高騰の影響あり、CRによる利益率改善が進行中

受注動向

半導体：民生需要が停滞の中、生成AI/中国需要が下支え

- 生成AI・HPC：プロセッサの需要が増加、AIパッケージ向けグラインダも堅調
- 中国需要：パワー半導体を除き、一定の水準の需要が継続
- パワー関連：Si/SiCともに 今後1年~1.5年程度 低迷継続
- グローバルOSAT：稼働率は緩やかな回復基調、ハイエンド中心に需要増加傾向になることを想定

計測：新規生産ライン向け投資が見込みづらい中、更新投資や充放電試験システムの事業機会を捉える

- 今期予想の前提について、11ページに記載しています。
青字が、11月の説明からの変更点です。
- 上段の、売上・利益の前提については、変更はございませんが、現時点での出荷計画を踏まえ、業績予想を修正しています。
- 下段の受注の前提について、一部 見方を変更しています。
- 生成AI・HPC向けの需要は、11月想定よりも強くなっています。
- 中国需要は、現在も一定の水準で推移しています。
現時点で各種規制の直接的な影響は受けておりません。今後の動向を注視します。
- パワー半導体関連の需要は、11月想定より、さらに減速しています。
現時点では、1年半程度は停滞するシナリオとしています。

2024年度 業績予想



全社業績(億円)	2023年度		2024年度		
	通期		通期予(今回)	前回予想比	前期比
売上高	1,347		1,460	+10	+8%
営業利益 (営業利益率)	253 (19%)		285 (20%)	+5	+13%
経常利益	265		285	+5	+8%
当期純利益	194		233	+3	+20%
1株配当	192円		228円	-	+36円

セグメント別業績 (億円)		2023年度				2024年度				
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q予	前回予想比
半導体 製造装置	受注高	203	220	202	236	271	246	295		
	売上高	187	282	176	355	220	323	230	332	+10
計測機器	受注高	92	80	100	76	103	91	98		
	売上高	79	87	78	103	76	95	87	97	±0

- 2024年11月に開示した通期業績予想を修正（半導体を上方修正）
- 前提為替レートは145円/ドルを据え置き（為替変動影響は軽微：円建て比率高）

February 4th, 2025

Copyright 2025 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

12

- 以上の前提を踏まえ、半導体の売上高予想の上方修正に伴い、各利益の予想をご覧のように修正いたしました。
- 以上が業績予想に関する説明となります。
- 最後に、お知らせとなります。
通期決算開示は5月を予定しておりますが、これに合わせて2025年度からの新しい中期経営計画を、ご案内させていただく所存です。
- 現在は、5月9日 金曜日を軸に調整しており、準備が整い次第、ご案内申し上げます。
- 以上で、私からの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。



IR情報



<https://www.accretech.com/jp/ir/index.html>

サステナビリティ情報



<https://www.accretech.com/jp/sustainability/index.html>

補足資料

Supplementary Data

セグメント別業績推移 Segment Information



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter								
	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2024年3月期 FY2024/3				2025年3月期 FY2025/3				
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
Orders 高注 高	半導体 SPE	93,181	152,896	99,366	86,082	20,345	21,957	20,175	23,604	27,081	24,631	29,456	
	計測 Metr.	23,878	33,159	36,960	34,802	9,225	7,981	9,963	7,632	10,336	9,082	9,781	
	合計 Total	117,060	186,056	136,326	120,885	29,571	29,938	30,139	31,236	37,417	33,713	39,237	
Backlog 高注 高	半導体 SPE	50,619	102,370	89,371	75,398	90,993	84,710	87,300	75,398	80,433	72,785	79,205	
	計測 Metr.	6,301	9,904	12,428	12,606	13,758	13,061	15,253	12,606	15,362	14,911	16,031	
	合計 Total	56,920	112,274	101,799	88,004	104,752	97,771	102,553	88,004	95,796	87,697	95,236	
Sales 高上 高	半導体 SPE	71,745	101,145	112,365	100,055	18,722	28,241	17,585	35,505	22,046	32,280	23,036	
	計測 Metr.	25,359	29,556	34,436	34,624	7,895	8,678	7,772	10,278	7,580	9,532	8,661	
	合計 Total	97,105	130,702	146,801	134,680	26,618	36,919	25,357	45,784	29,626	41,812	31,698	
Op. 利益 高	半導体 SPE	13,565	24,698	29,866	19,899	3,208	5,773	1,912	9,004	3,314	7,824	4,449	
	計測 Metr.	1,996	3,628	4,628	5,408	1,042	1,365	1,084	1,916	768	1,497	1,220	
	合計 Total	15,562	28,327	34,494	25,307	4,250	7,138	2,997	10,921	4,083	9,322	5,670	
Op. 利益 率	半導体 SPE	18.9%	24.4%	26.6%	19.9%	17.1%	20.4%	10.9%	25.4%	15.0%	24.2%	19.3%	
	計測 Metr.	7.9%	12.3%	13.4%	15.6%	13.2%	15.7%	14.0%	18.6%	10.1%	15.7%	14.1%	
	合計 Total	16.0%	21.7%	23.5%	18.8%	16.0%	19.3%	11.8%	23.9%	13.8%	22.3%	17.9%	

損益計算書 Statements of Income



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2024年3月期 FY2024/3				2025年3月期 FY2025/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高 Net Sales	97,105	130,702	146,801	134,680	26,618	36,919	25,357	45,784	29,626	41,812	31,698	
売上原価 Cost of goods sold	60,190	77,694	84,967	79,917	15,415	22,387	14,894	27,220	17,753	24,757	17,960	
売上総利益 Gross Profit on Sales	36,914	53,008	61,834	54,762	11,203	14,531	10,462	18,564	11,873	17,054	13,738	
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	21,351	24,681	27,339	29,454	6,952	7,392	7,465	7,643	7,790	7,732	8,067	
営業利益 Operating profit	15,562	28,327	34,494	25,307	4,250	7,138	2,997	10,921	4,083	9,322	5,670	
営業外収益 Non-operating income	540	987	965	1,404	563	245	52	541	287	39	539	
営業外費用 Non-operating expenses	235	153	162	259	103	22	64	67	41	531	-422	
経常利益 Recurring Profit	15,867	29,160	35,297	26,453	4,710	7,361	2,985	11,394	4,329	8,829	6,632	
特別利益 Extraordinary gains	1,354	390	103	824	26	-	3	794	10	4,483	0	
特別損失 Extraordinary losses	1,074	34	2,099	21	-	14	-	7	-	-	157	
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	16,147	29,516	33,301	27,255	4,736	7,347	2,989	12,181	4,339	13,312	6,474	
法人税等合計 Total Income tax and others	3,978	8,132	9,607	7,791	1,456	1,998	897	3,437	754	3,310	1,870	
非支配株主に帰属する四半期純利益 Net Profit attributable to minority interests	-6	57	62	84	33	46	24	-19	31	6	29	
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	12,175	21,326	23,630	19,378	3,245	5,302	2,067	8,763	3,554	9,996	4,574	
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (Yen)	293.83	522.52	581.33	480.49	80.63	131.49	51.23	217.00	87.89	247.09	113.07	
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	291.43	517.51	575.62	475.42	-	-	-	-	-	-	-	-

February 4th, 2025

Copyright 2025 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

16

貸借対照表 Balance Sheet



(百万円) (Million Yen)	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期(3Q末) FY2025/3 (3Q)	
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	49,033	40,080	36,782	53,023
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	38,367	43,403	42,801	32,621
	在庫 Inventories	40,325	53,482	67,225	74,933
	その他 Others	6,103	7,005	7,022	4,090
	合計 Total	133,829	143,972	153,831	164,668
固定資産合計 Total Fixed Assets	56,457	65,060	71,693	65,624	
総資産 Total Assets	190,287	209,032	225,524	230,292	
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	29,876	22,359	17,845	18,680
	その他 Others	25,765	28,588	28,156	27,648
	合計 Total	55,641	50,947	46,002	46,328
固定負債合計 Total long-term liabilities	3,564	12,057	21,094	15,880	
負債合計 Total Liabilities	59,206	63,004	67,097	62,208	
純資産合計 Total Net Assets	131,081	146,028	158,427	168,083	
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets	190,287	209,032	225,524	230,292	
有利子負債合計 Total interest-bearing debt	5,497	14,191	25,171	21,089	
自己資本比率 Equity Ratio(%)	68.1%	69.0%	69.4%	72.2%	
自己資本利益率 ROE(%)	17.4%	17.3%	12.9%	-	

※1: 電子記録債権、契約資産を含む

Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む

Incl. Electronically recorded obligations-operating

各種費用, キャッシュフロー Expenses and Cash Flows



(百万円) (Million Yen)	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期(3Q) FY2025/3(3Q)
試験研究費 R&D expenses	8,146	8,542	9,042	7,595
設備投資 Capex	9,793	9,725	11,602	6,376
減価償却費 (のれんの償却を除く) Depreciation (excl. Amortization of goodwill)	3,551	3,832	4,673	3,765

(百万円) (Million Yen)	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期(上期) FY2025/3(1H)
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	23,837	1,000	4,892	19,997
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-8,990	-8,421	-10,563	7,929
フリーキャッシュフロー Free cash flows	14,846	-7,421	-5,671	27,926
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-10,346	-2,174	1,616	-6,732
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	882	625	755	381
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	49,006	40,036	36,736	58,312

従業員数推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算